# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)



NICOLAI, Jean-Marc [FR/FR]; 1 bis, Rouget de Lisles, F-92400 Courbevoie (FR). DUARTE, Marc [FR/FR]; 5, rue

du Bac, F-93360 Neuilly Plaisance (FR).

postale 150, F-94017 Créteil (FR).

(74) Mandataire: BONNANS, Arnaud; Valeo Management Services, Propriété Industrielle, 2, rue André Boulle, Boîte

# ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Bureau international

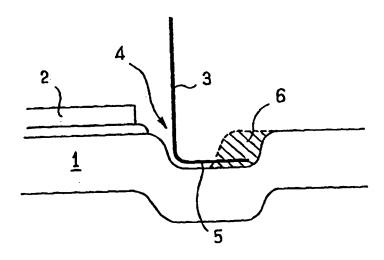


### DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

WO 99/45755 (51) Classification internationale des brevets 6: (11) Numéro de publication internationale: A1 H05K 9/00 (43) Date de publication internationale:10 septembre 1999 (10.09.99) PCT/FR99/00462 (81) Etats désignés: DE, JP, US. (21) Numéro de la demande internationale: (22) Date de dépôt international: 2 mars 1999 (02.03.99) Publiée Avec rapport de recherche internationale. (30) Données relatives à la priorité: 2 mars 1998 (02.03.98) FR 98/02478 (71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): VALEO VISION [FR/FR]; 34, rue Saint André, F-93000 Bobigny (FR). (72) Inventeurs; et (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): KONG A SIOU, Dung [FR/FR]; 23, avenue V. Hugo, F-94600 Choisy le Roy (FR).

(54) Title: SHIELDING AN ELECTRONIC CARD WITH PRINTED CIRCUIT MOUNTED ON A METAL SUBSTRATE

(54) Titre: BLINDAGE D'UNE CARTE ELECTRONIQUE A CIRCUIT IMPRIME MONTEE SUR UN SUBSTRAT METALLIQUE



(57) Abstract

The invention concerns an assembly comprising an electronic card (2) with printed circuit mounted on a metal substrate (1), and a shielding metal package cap (3) electrically connected to the substrate (1). The substrate (1) has a hollow groove (4) wherein the package cap (3) edge is set on said substrate (1) in the groove. The invention also concerns a method for making such an assembly.

•

1

#### (57) Abrégé

L'invention propose un ensemble comportant une carte électronique (2) à circuit imprimé montée sur un substrat (1) métallique, ainsi qu'un capot (3) métallique de blindage électriquemenmt connecté au substrat (1). Le substrat (1) présente une gouttière en creux (4) dans laquelle le bord du capot (3) est reçu. Ledit bord est serti sur ledit substrat (1) dans la gouttière (4). L'invention propose également un procédé de réalisation d'un tel ensemble.

#### UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

4.	Afficials	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AL	Albanie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AM	Arménie Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
AT		GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
AU	Australie	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
AZ	Azerbaidjan	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BA	Bosnie-Herzégovine	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
BB	Barbade	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave	TM	Turkménistan
BE	Belgique			WILL	de Macédoine	TR	Turquie
BF	Burkina Faso	GR	Grèce	ML	Mali	TT	Trinité-et-Tobago
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	MN	Mongolie	UA	Ukraine
BJ	Bénin	ΙE	Irlande		Mauritanie	UG	Ouganda
BR	Brésil	IL	Israël	MR		US	Etats-Unis d'Amérique
BY	Bélarus	IS	Islande	MW	Malawi		Ouzbékistan
CA	Canada	IT	Italie	MX	Mexique	UZ	
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NE	Niger	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NL	Pays-Bas	YU	Yougoslavie
CH	Suisse	KG	Kirghizistan	NO	Norvège	zw	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire	NZ	Nouvelle-Zélande		
CM	Cameroun		démocratique de Corée	PL	Pologne		
CN	Chine	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CU	Cuba	KZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
CZ	République tchèque	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
DE	Allemagne	LI	Liechtenstein	SD	Soudan		

SE

Suède

Singapour

Sri Lanka

Libéria

LK

DK

EE

Danemark

Estonie

1

## "BLINDAGE D'UNE CARTE ÉLECTRONIQUE À CIRCUIT IMPRIMÉ MONTÉE SUR UN SUBSTRAT MÉTALLIQUE"

La présente invention est relative au blindage électromagnétique d'une carte électronique à circuit imprimé montée sur un substrat métallique.

5

10

20

25

30

35

Elle trouve avantageusement - mais non limitativement - application pour la protection des circuits de commande de lampes à décharge.

Un tel blindage électromagnétique est généralement réalisé au moyen d'un capot métallique refermé sur le substrat.

À ce jour, on utilise principalement deux types de techniques pour le montage d'un tel capot.

Selon un premier type de solution, la connexion électrique du capot métallique à la masse que constitue le substrat métallique est réalisée de facon indépendante de la fixation mécanique dudit capot par rapport audit substrat et à la carte électronique. Par exemple, la connexion électrique à la masse peut être alors réalisée par des moyens tels qu'un rivetage, un vissage, une soudure ou encore une liaison filaire soudée.

Dans un deuxième type de solution, le capot métallique est fixé mécaniquement sur le substrat par l'intermédiaire d'un collage qui est en un matériau électriquement conducteur et qui assure la fonction de connexion électrique.

Toutefois, ces deux types de solutions présentent l'une et l'autre des inconvénients.

Notamment, les solutions dans lesquelles la fixation mécanique et la connexion électrique sont réalisées par des moyens différents nécessitent des opérations supplémentaires lors de la fabrication et sont d'un coût élevé.

2

En outre, avec ces solutions, l'étanchéité entre le capot métallique et le substrat n'est généralement pas assurée.

Également, les solutions dans lesquelles on utilise un collage conducteur sont également d'un coût important et ce notamment du fait de l'opération de report d'un cordon de colle.

En outre, avec ces solutions, les joints de colle posent des problèmes de tenue dans le temps, ainsi que de tenue en température et aux vibrations.

10

15

20

30

35

Un but de l'invention est de proposer une solution de blindage qui ne présente pas ces inconvénients.

À cet effet, l'invention propose un ensemble comportant une carte électronique à circuit imprimé montée sur un substrat métallique, ainsi qu'un capot métallique de blindage électriquement connecté au substrat, le substrat présentant une gouttière en creux dans laquelle le bord du capot est reçu, ledit bord étant serti sur ledit substrat dans la gouttière.

L'invention propose également un procédé pour la réalisation d'un tel ensemble caractérisé par les étapes suivantes :

- on emboutit le substrat pour y réaliser une gouttière,
- on assemble la carte électronique sur ledit substrat,
  - on positionne le capot sur l'ensemble ainsi obtenu, en disposant le bord dudit capot dans ladite gouttière,
    - on sertit ledit bord sur ledit substrat.

D'autres caractéristiques de l'invention ressortiront encore de la description qui suit. Cette description est purement illustratrice et non limitative. Elle doit être lue en regard des dessins annexés sur lesquels:

3

- la figure 1 est une représentation schématique en vue en coupe illustrant une fixation d'un capot de blindage conforme à un mode de réalisation possible pour l'invention;

- les figures 2a et 2b sont des représentations schématiques en vue de dessus illustrant deux modes de sertissage possibles ;

5

10

15

25

30

- les figures 3 et 4 sont des représentations schématiques en vue en coupe semblables à celle de la figure 1 illustrant un mode de mise en œuvre possible pour le sertissage du capot métallique sur le substrat.

Sur la figure 1, on a représenté un substrat métallique 1, une carte électronique à circuit imprimé 2 et un capot métallique de blindage 3.

Le substrat 1 présente une gouttière en creux 4 réalisée par emboutissage de la matière. Cette gouttière 4 s'étend sur ledit substrat selon un contour qui correspond à celui du bord du capot métallique 3.

Cette gouttière 4 est destinée à recevoir le bord du capot métallique 3.

La fixation du bord du capot métallique 3 dans la gouttière 4 est réalisée par sertissage.

À cet effet, ledit bord se prolonge par une ou plusieurs pattes 5, qui forment un retour en L s'étendant vers l'extérieur du capot 3.

Une telle patte 5 est reçue dans une zone de la gouttière 4 qui est conformée avec une largeur qui coïncide avec celle de ladite patte 5. Ainsi, ladite patte 5 s'insère exactement dans la forme en creux de la gouttière 4.

La longueur d'une telle patte 5 est par exemple de 3 mm, tandis que celle d'un motif en creux qui la reçoit est de 4 mm.

Le montage du capot 3 sur le substrat 1 se fait de la façon suivante.

4

Le substrat 1 est d'abord embouti, de façon à réaliser la gouttière 4. On obtient par là même un excédent de matière qui constitue en l'occurrence le bord de la gouttière 4.

Puis, la carte électronique 2 est assemblée sur le substrat 1.

Le capot 3 est alors mis en place dans la gouttière 4.

10

15

20

25

30

35

Lorsque le capot 3 est correctement positionné, on réalise un sertissage localisé, par déplacement latéral de la matière du substrat au-dessus de coins des pattes 5 du capot 3. La matière déplacée lors du sertissage est celle de de la gouttière issue bords les ainsi que particulièrement, Plus l'emboutissage. l'illustrent les figures 2a et 2b, la matière repoussée par l'emboutissage lors de la formation de la gouttière vient exercer après sertissage sur les pattes 5 des efforts parallèles se compensant. La matière déplacée lors du sertissage est référencée par 6.

Deux modes de réalisation sont possibles: le sertissage peut être réalisé par un écrasement d'une partie assez courte du substrat venant recouvrir des pattes 5 assez longues (figure 2a); en variante, il peut être réalisé par un écrasement simultané de deux parties du substrat venant recouvrir des pattes 5 assez courtes (figure 2b).

Ainsi que l'illustrent les figures 3 et 4, le moule dans lequel le substrat 1 est embouti peut être conformé de façon que ledit substrat 1 embouti présente au bord de la gouttière 4 une protubérance 7 qui constitue l'excédent de matière à déplacer lors du sertissage ; l'altitude de cette protubérance est ajustée pour rester inférieure au niveau supérieur de la carte électronique 2, de façon à ne pas empêcher la sérigraphie de la pâte à braser pour le montage des composants préalablement à la mise en place du capot 3.

5

Par ailleurs, la profondeur de la gouttière 4 est ajustée pour que le fond de ladite gouttière 4 et le retour 5 soient en dessous de la carte électronique 2. Ceci permet de prévenir tout risque de fuite d'ondes électromagnétiques.

Avantageusement, lors du sertissage initial, seule une partie des pattes du capot 5 est utilisée, ce qui permet de se réserver la possibilité d'utiliser les autres pattes pour, dans l'hypothèse d'un démontage ultérieur, un deuxième sertissage.

Par conséquent, le procédé qui vient d'être décrit est compatible avec un démontage du capot.

10

15

20

25

30

La technique qui vient d'être décrite présente de nombreux avantages :

- elle est d'une plus grande simplicité que les techniques antérieures, puisque le montage mécanique du capot, le positionnement de celui-ci et la mise en contact électrique du capot et du substrat métallique sont réalisés en une seule opération;
- le montage réalisé permet une absence de fuites d'ondes électromagnétiques ;
- le substrat métallique reste parfaitement étanche, puisqu'il est dépourvu de perforations ;
- la rigidité mécanique de l'ensemble du montage est augmentée ; en particulier, la gouttière réalisée sur l'ensemble du pourtour du substrat métallique constitue une nervure qui contribue à cette rigidité ; cette rigidité est également augmentée par l'emboutissage du capot lors de son sertissage sur le substrat métallique ; on notera que l'augmentation de la rigidité obtenue permet de réduire l'épaisseur du substrat métallique ;
  - également, avec la technique proposée, il est possible de démonter puis de remonter le capot.

Le blindage qui, vient d'être décrit peut être 35 utilisé dans tous les domaines de l'électronique où sont

6

utilisés les substrats métalliques isolés et notamment de façon avantageuse en électronique automobile, conversion d'énergie, alimentation de puissance, multiplexeur de puissance, alimentation de moteur électrique, etc.

En particulier il peut être mis en oeuvre dans le blindage du circuit de commande ("ballast" selon la terminologie de l' Homme du Métier) d'une lampe à décharge où le problème des fuites d'ondes électromagnétiques n'était jusqu'à présent pas totalement résolu.

# REVENDICATIONS

- 1. Ensemble comportant une carte électronique (2) à circuit imprimé montée sur un substrat (1) métallique, ainsi qu'un capot (3) métallique de blindage électriquement connecté au substrat (1), le substrat (1) présentant une gouttière en creux (4) dans laquelle le bord du capot (3) est reçu, caractérisé en ce que ledit bord est serti sur ledit substrat (1) dans la gouttière (4).
- 2. Ensemble selon la revendication 1, caractérisé en ce que le bord du capot (3) se termine par au moins une patte (5) en retour qui est sertie dans la gouttière (4).

10

15

30

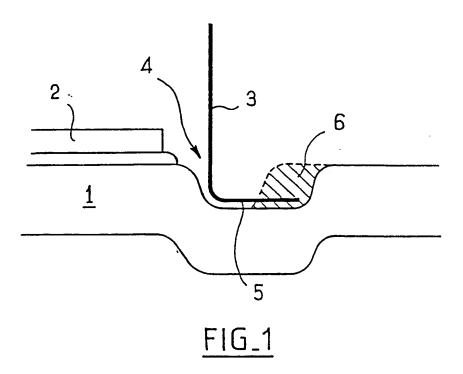
- 3. Ensemble selon la revendication 2, caractérisé en ce que le fond de ladite gouttière (4) et ladite patte (5) sont en dessous de la carte électronique (2).
  - 4. Procédé pour la réalisation d'un ensemble selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par les différentes étapes suivantes :
- on emboutit le substrat (1) pour y réaliser une gouttière (4),
  - on assemble la carte électronique (2) sur ledit substrat,
- on positionne le capot (3) sur l'ensemble ainsi obtenu, en disposant le bord dudit capot (3) dans ladite gouttière (4),
  - on sertit ledit bord sur ledit substrat (1).
  - 5. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le sertissage se fait par écrasement localisé de matière du substrat (1) sur une ou plusieurs pattes qui terminent le bord du capot (3), de façon à exercer sur la ou lesdites pattes (5) des efforts opposés qui se compensent.
  - 6. Procédé selon l'une des revendications 4 et 5, s caractérisé en ce que l'emboutissage forme au bord de la

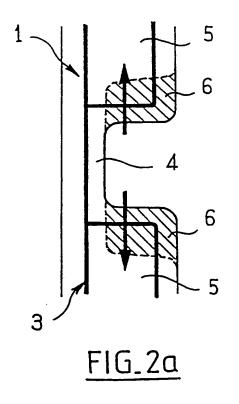
8

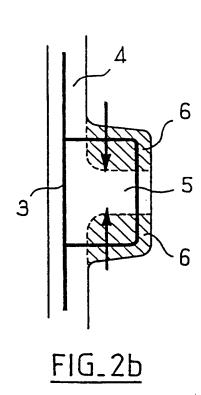
gouttière une protubérance destinée à constituer la matière à déplacer lors du sertissage.

7. Procédé selon l'une des revendications 4 à 6, caractérisé en ce que seule une partie des pattes du capot (3) est sertie.

1/2

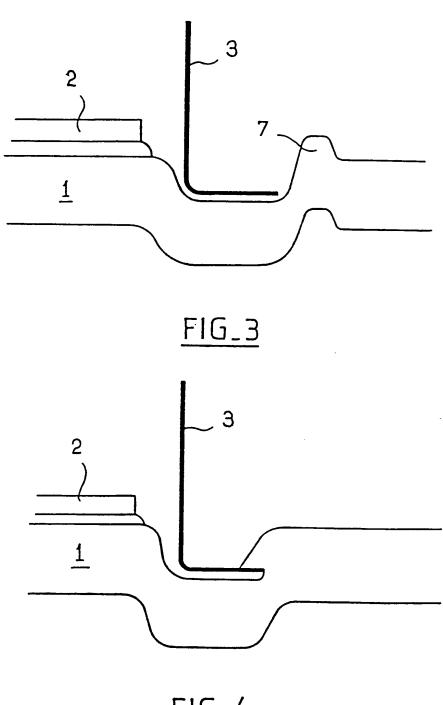








2/2



FIG\_4





Int ional Application No PCT/FR 99/00462

A. CLASSIF	FICATION OF SUBJECT MATTER H05K9/00		
	International Control Observation (ISO) and the Ison Control of th	eation and IPC	
	International Patent Classification (IPC) or to both national classific	Janon and IFO	<del></del>
_	SEARCHED currentation searched (classification system followed by classification	ion symbols)	
IPC 6	H05K		_
Documentati	tion searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are included in the fields se	arched
!			
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data be	ase and, where practical, search terms used	)
			<del></del>
	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	alevant naceance	Relevant to claim No.
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	siovani passayes	пенечанию скаіт Мо.
χ	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN		1
, and	vol. 098, no. 005, 30 April 1998		
	& JP 10 022679 A (SAITAMA NIPPO	N DENKI	
_	KK), 23 January 1998 see abstract		2-7
Α			_ ,
Α	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN	0 1000	1-7
	vol. 013, no. 248 (E-770), 9 Jun & JP 01 049300 A (MITSUBISHI EL		
	CORP), 23 February 1989		
	see abstract		
_	US 5 559 676 A (GESSAMAN MARTIN	J)	1-7
A	24 September 1996		
	see column 3, line 28 - line 42;	figure 2	
L			
Furt	ther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.
° Special ca	ategories of cited documents :	"T" later document published after the inte	
"A" docume	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance	or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or th	the application but
"E" earlier	document but published on or after the international	invention "X" document of particular relevance; the	
filing of "L" docume	ent which may throw doubts on priority claim(s) or	cannot be considered novel or canno involve an inventive step when the do	t be considered to ocument is taken alone
citatio	is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the cannot be considered to involve an in	ventive step when the
other	nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means	document is combined with one or ments, such combination being obvious to the art	
	ent published prior to the international filing date but than the priority date claimed	in the art. "&" document member of the same patent	1 family
	actual completion of the international search	Date of mailing of the international se	arch report
1	June 1999	09/06/1999	
Name and	mailing address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk		
1	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Rubenowitz, A	

1



information on patent family members

Interional Application No
PCT/FR 99/00462

			<del></del>		D. A. F San
	Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
	US 5559676	A 2	24-09-1996	NONE	
- !					

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE



De de Internationale No PCT/FR 99/00462

A. CLASSEN	MENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE		
CIB 6	H05K9/00		
	sification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classificat	ion nationale et la CIB	
	ES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE on minimale consultée (système de classification suivi des symboles de	classement)	
CIB 6	H05K		
			The same a part to make robe
Documentati	on consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où c	es documents relèvent des domaines su	ir lesqueis a pone la recherche
		m de la base de desprées, et si réalisable	o termes de recherche utilisés)
Base de don	nées électronique consultée au cours de la recherche internationale (no	om de la dase de dointees, et si realisadi	e, terries de recriereire dimeso,
	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication de	es passages pertinents	no. des revendications visées
Guioguiio			
Х	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN		1
	vol. 098, no. 005, 30 avril 1998 & JP 10 022679 A (SAITAMA NIPPON I	DENKT	
	KK), 23 janvier 1998	CIVIL	
Α	voir abrégé		2-7
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN		1-7
	vol. 013, no. 248 (E-770), 9 juin	1989	
	& JP 01 049300 A (MITSUBISHI ELEC CORP), 23 février 1989	IKIC	
	voir abrégé		
A	US 5 559 676 A (GESSAMAN MARTIN J)		1-7
^	24 septembre 1996	•	
	voir colonne 3, ligne 28 - ligne 4 figure 2	2;	
	Consulation de la lieute des descriptions	Y Les documents de familles de br	evets sont indiqués en annexe
Voir	la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	X Les documents de familles de br	
1		" document ultérieur publié après la dat date de pnorité et n'appartenenant p	as à l'état de la
consid	ent définissant l'état général de la technique, non déré comme particulièrement pertinent	technique pertinent, mais cité pour c ou la théorie constituant la base de l'	invention
ou ap	rés cette date	document particulièrement pertinent; etre considerée comme nouvelle ou	comme impliquant une activité
l priorit	ent pouvant jeter un doute sur une revendication de é ou cité pour déterminer la date de publication d'une citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)	nyentive par rapport au document or sociament particulièrement pertinent; ne peut etre considérée comme impl	l'inven tion revendiquée
"O" docum	vicialisto de por une divulgation orale, à un usage, à exposition ou tous autres moyens	reque le document est associé à ut	n ou plusieurs autres
"P" docum	ont publis avent le date de dénôt international, mais	pour une personne du métier document qui fait partie de la même fi	
	uelle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d expedition du présent rapport	
		09/06/1999	
L	juin 1999		
Nom et adr	esse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2	Fonctionnaire autorisé	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Rubenowitz, A	
	Fax: (+31-70) 340-3016	", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ",	

Renseignements relatirs aux membres de familles de brevets

PCT/FR 99/00462

Membre(s) de la famille de brevet(s) Date de Document brevet cité Date de publication au rapport de recherche publication AUCUN 24-09-1996 US 5559676

			CI/FR 99/	700462
A. CLASSEI CIB 6	MENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE H05K9/00			
	and the second s	tion nationale at la CID		
	ssification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classificat	ion nationale et la CIB		
	IES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE ion minimale consultée (système de classification suivi des symboles de	classement)		
CIB 6	H05K			
Documentat	ion consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où c	es documents relèvent	des domaines su	ir lesquels a porté la recherche
Base de dor	nnées électronique consultée au cours de la recherche internationale (no	om de la base de donne	ées, et si réalisabl	le, termes de recherche utilisés
C DOCUME	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		<del></del>	
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication de	es passages pertinents		no. des revendications visées
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 098, no. 005, 30 avril 1998	D. CANY T		1
	& JP 10 022679 A (SAITAMA NIPPON I KK), 23 janvier 1998	DENK I		
Α	voir abrégé 			2-7
Α	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 248 (E-770), 9 juin & JP 01 049300 A (MITSUBISHI ELEC' CORP), 23 février 1989 voir abrégé	1989 TRIC		1-7
Α	US 5 559 676 A (GESSAMAN MARTIN J) 24 septembre 1996 voir colonne 3, ligne 28 - ligne 4 figure 2	2;		1-7
Voir	la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	χ Les documents	de familles de bre	evets sont indiqués en annexe
"A" docum	s spéciales de documents cités: "T ent définissant l'état général de la technique, non déré comme particulièrement pertinent	date de priorité et n'	'appartenenant pa mais cité pour co	omprendre le principe
"E" docum ou ap "L" docume priorit	ent antérieur, mais publié à la date de dépôt international "X rès cette date ent pouvant jeter un doute sur une revendication de	<ul> <li>document particulière être considérée con inventive par rappoi</li> <li>document particulière</li> </ul>	ement pertinent; l' nme nouvelle ou c rt au document co ement pertinent; l'	'inven tion revendiquée ne peu comme impliquant une activité onsidéré isolément l'inven tion revendiquée
"O" docum une e "P" docum	nent se référant à une divulgation orale, à un usage, à exposition ou tous autres moyens	lorsque le documen	it est associé à un ne nature, cette co du métier	iquant une activité inventive nou plusieurs autres ombinaison étant évidente amille de brevets
<u> </u>	uelle la recherche internationale a été effectivement achevée			de recherche internationale
	. juin 1999	09/06/19	99	·
Nom et adre	esse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2	Fonctionnaire autor	isé	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Rubenowi	tz, A	

.

# RAPPORT DE RECHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

hande Internationale No PCT/FR 99/00462

nenseignements relatirs aux m	empres de rammes de biovolo	PCT/FR	PCT/FR 99/00462		
Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication		
US 5559676 A	24-09-1996	AUCUN			
			·		
		1.41			
	-				
•					

THIS PAGE BLANK (USPTO)